

容傳媒

## 南華大學半導體應用學士學位學程 建構跨域檢測與封裝技術新藍圖 (<https://fusion.ikh.tw/?Pn=Vw&Id=88k2jg57j748#Vw>)

2026/04/28

### 南華大學半導體應用學士學位學程 建構跨域檢測與封裝技術新藍圖

2026/04/28 / 作者：張嘉盛/嘉義 /

隨著次微米製程(Sub-10nm)與 2.5D/3D 晶片封裝異質整合的快速發展，半導體產線已由「如何製造」轉向「如何精準檢測與除錯」。南華大學新成立之「半導體應用學士學位學程」，特別聚焦建構跨域整合之除錯藍圖，於日前辦理「先進半導體封裝與異質整合檢測技術論壇」，冀培養能串聯全球頂尖檢測硬體量能，整合物理形貌與材料行為分析，轉化為解決產線良率痛點的實務能力，吸引對半導體製程與先進封裝有興趣的學生參加，

論壇主持人黃慶成博士為南華大學特聘教授兼半導體應用學士學位學程主任，擁有豐富產學研合作及多年產業推動經驗，曾赴美國矽谷史丹福產業研究院(SRI)進行創新開發訓練研究，114年其研究團隊成功開發仿生關鍵材料取得專利並及商業化獲得「2025美國達文西全球創新科技獎」。

本次論壇並邀請日商 KEYENCE 經理簡曼軒分享目前半導體一線研發及良率管控的頂級 3D 數位顯微技術；邀請美商 TA Instruments 資深區域經理蔡百軒，分享目前半導體一線研發及封測管控的頂尖熱力學分析，破解先進封裝最致命的晶片翹曲謎題。論壇壓軸，由該學程主任黃慶成教授與產業代表澄譽科技有限公司董事長黃名宏展開一對一深度對話，為南華大學半導體應用學士學位學程「跨域解方與人才破局」，打造次世代「畢業即戰力」。

南華大學校長高俊雄表示，配合政府推動「南方大矽谷」及科技產業南移政策，嘉義太保正如如火如荼興建台積電封測廠。南華大學早於114年即洞察產業趨勢轉變，獲董事會大力支持，建置黃光製程、化學機械研磨製程、潔淨製程與材料實驗室，並添購多項高階研究設備，包括薄膜/微粒介連電位儀、動態表面張力儀、熱膨脹係數測量儀及熱動態機械分析儀等，皆屬數百萬元等級之專業儀器，設備規模與水準即使在頂尖大學單一科系中亦屬少見。

南華大學「半導體應用學士學位學程」自去(114)年7月啟動籌設作業，目前已陸續到位。首屆招生無論是特殊選才、繁星推薦均是滿招，並將於今(115)年9月正式迎來首屆新生。個人申請入學第二階段面試預計於5月15日至17日登場，歡迎對前端科技有興趣的考生踴躍報考。

